

无锡泰连芯科技有限公司

TLX42xV 型
精密可编程基准源

2024 年 06 月

TLX421V/TLX422V 精密可编程基准源

1 特性

- 25°C 时的基准电压容差 0.5%
- 可编程输出电压至 12V
- 低动态输出阻抗 0.03Ω
- 0.05mA 至 100mA 的灌电流能力
- 等效全量程温度系数：25ppm/°C（典型值）
- 温度补偿，可在整个额定工作温度范围内运行
- 低输出噪声电压
- 快速启动响应
- 工作结温范围：-55°C ~ 125°C
- 封装：SOT23

2 应用

- 可编程电压和电流基准
- 电源
- 齐纳替代
- 电压监控
- 带集成基准的比较器
- 作为精密基准电压源

3 概述

TLX421V 和 TLX422V 器件是三端可调并联稳压器，在适用温度范围内保证热稳定性。输出电压可采用两个外部电阻器设置为 V_{REF} （约 1.24V）和 12V 之间的任意值。这些器件具有非常快速的导通特性，使这些器件在许多应用中成为齐纳二极管的理想替代品。

TLX421V 和 TLX422V 初始容差（25 °C 时）为 0.5%。

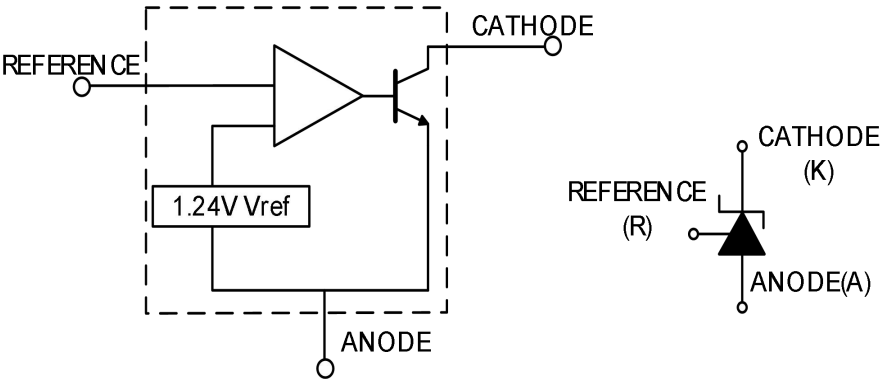
质量等级：军温级&N1级

器件信息 ⁽¹⁾

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX421V	SOT23	1.30mm×2.92mm
TLX422V	SOT23	1.30mm×2.92mm

(1) 详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

4 功能框图



目录

1 特性	2
2 应用	2
3 概述	2
4 功能框图	2
5 修订历史	4
6 封装和订单说明 ⁽¹⁾	5
7 引脚定义和功能	6
8 规格	7
8.1 绝对最大额定参数	7
8.2 ESD 等级	7
8.3 推荐工作条件	7
8.4 典型电气参数	8
8.5 典型应用电路	9
8.6 典型参数曲线	10
9 封装规格尺寸	12
10 包装规格尺寸	13

5 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.0	2024/09/20	初始版
A.1	2025/02/19	正式版

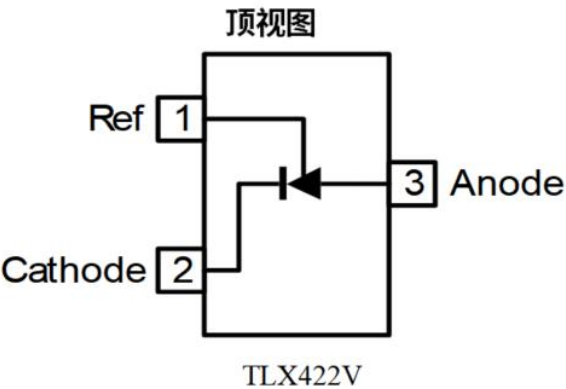
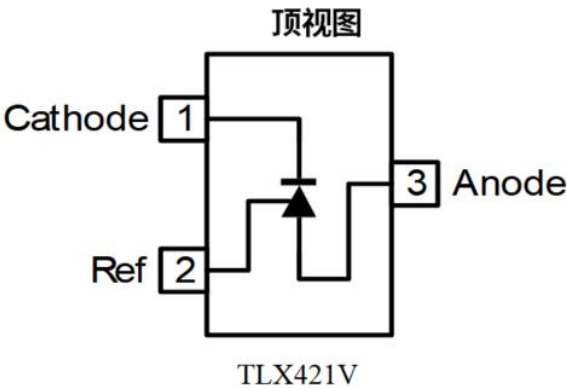
6 封装和订单说明⁽¹⁾

订购型号	温度等级	封装类型	MSL	质量等级
JTLX421VXSf3	-55 °C ~+125 °C	SOT23	MSL1/3	N1/军温级
JTLX422VXSf3	-55 °C ~+125 °C	SOT23	MSL1/3	N1/军温级
TLX421VXSf3	-40 °C ~+125 °C	SOT23	MSL1/3	工业级
TLX422VXSf3	-40 °C ~+125 °C	SOT23	MSL1/3	工业级

注意:

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。
- (3) TLXIC 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 技术支持联系。

7 引脚定义和功能



引脚功能

引脚名称	引脚		功能说明
	TLX421V	TLX422V	
Cathode	1	2	并联电流/电压输入
Ref	2	1	相对于公共阳极的阈值
Anode	3	3	公共引脚，通常接地

8 规格

8.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）⁽¹⁾⁽²⁾

参数		符号	最小值	最大值	单位
阴极电压范围		V_{KA}	-0.3	14	V
阴极电流范围（连续）		I_{KA}	-100	155	mA
基准输入电流范围		I_{REF}	-0.05	10	mA
工作结温范围		T_{opr}	-55	125	°C
结至环境热阻 ⁽³⁾	SOT23	θ_{JA}		295	°C/W
储存温度范围		T_{stg}	-55	150	°C

(1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。

(2) 所有电压均相对于 GND 引脚测量。

(3) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。

8.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

			标称值	单位
$V_{(ESD)}$	静电放电	人体模型 (HBM), 符合 JEDEC EIA/ JESD22-A114 规范	±2000	V
		带电器件模型 (CDM)	±1000	V



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

8.3 推荐工作条件

在自然通风温度范围内（除非特别注明）

参数		符号	最小值	最大值	单位
阴极电压范围		V_{KA}	V_{REF}	12	V
阴极电流范围（连续）		I_{KA}	0.05	100	mA
自然通风条件下的工作温度范围		T_A	-55	125	°C

8.4 典型电气参数

(在推荐工作条件下，全温= -55°C~ +125°C, 典型值测试条件为 $T_A = +25^\circ\text{C}$ ，除非特别注明。)

参数	符号	测试条件		最小值 (1)	典型值 (2)	最大值 (1)	单位
基准输出电压	V_{REF}	$V_{KA}=V_{REF}$, $I_{KA}=10\text{mA}$	0.5%	1.234	1.24	1.246	V
基准输入电压随温度变化的偏差	ΔV_{REF}	$V_{KA}=V_{REF}$, $I_{KA}=10\text{mA}$ $T_A = -55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$		-	5	15	mV
基准输入电压变化与阴极电压变化之比	$\Delta V_{REF}/\Delta V_{KA}$	$I_{KA}=10\text{mA}$, $\Delta V_{KA}=12\text{V} \sim V_{REF}$		-	-1.7	-2.5	mV/V
基准输入电流	I_{REF}	$I_{KA}=10\text{mA}$, $R1=10\text{k}\Omega$, $R2=\infty$		-	0.15	0.4	μA
基准输入电流在全温度范围内的偏差	$\Delta I_{REF}/\Delta T_A$	$I_{KA}=10\text{mA}$, $R1=10\text{k}\Omega$, $R2=\infty$ $T_A = -55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$		-	0.1	0.4	μA
最小阴极电流	$I_{KA}(\text{min})$	$V_{KA}=V_{REF}$		-	40	50	μA
关态阴极电流	$I_{KA}(\text{OFF})$	$V_{KA}=14\text{V}$, $V_{REF}=0\text{V}$		-	0.05	2.5	μA
动态阻抗	Z_{KA}	$V_{KA}=V_{REF}$, $I_{KA}=1\text{mA to }100\text{mA}$ $f \leq 1.0\text{KHz}$		-	0.03	0.1	Ω

(1) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。

(2) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

8.5 典型应用电路

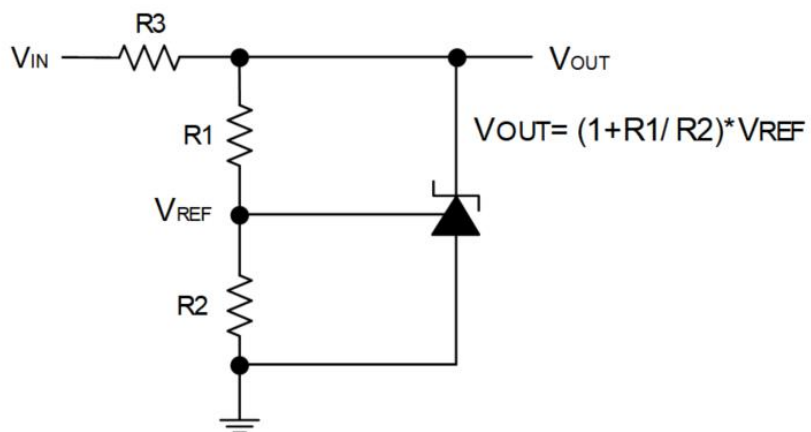


图 1. 并联稳压器

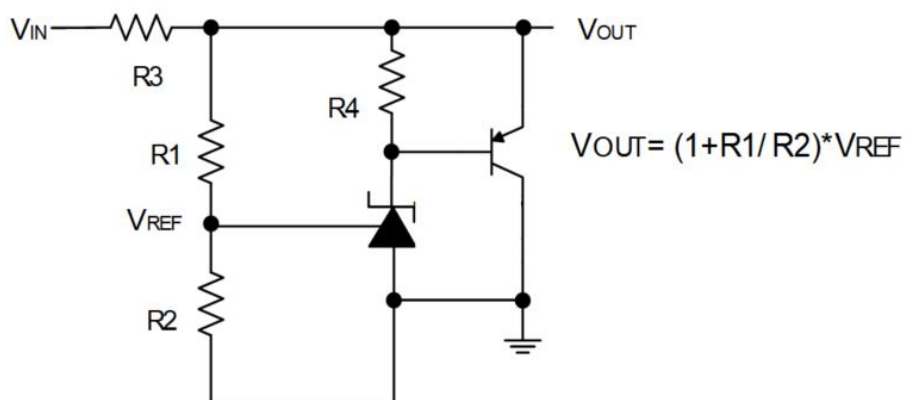


图 2. 大电流并联稳压器

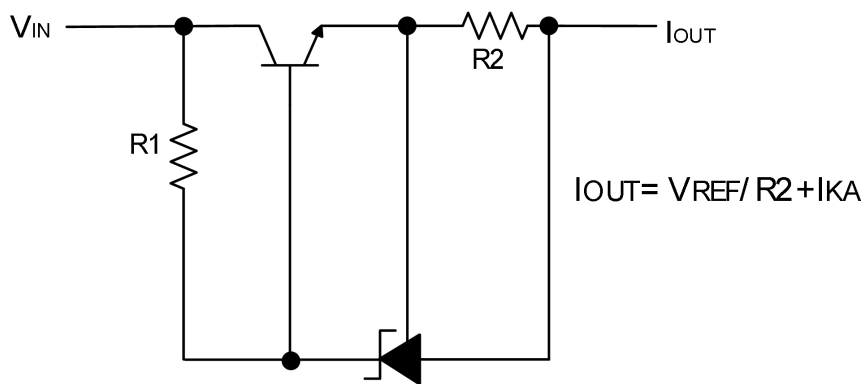


图 3. 电流源或电流限制

8.6 典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

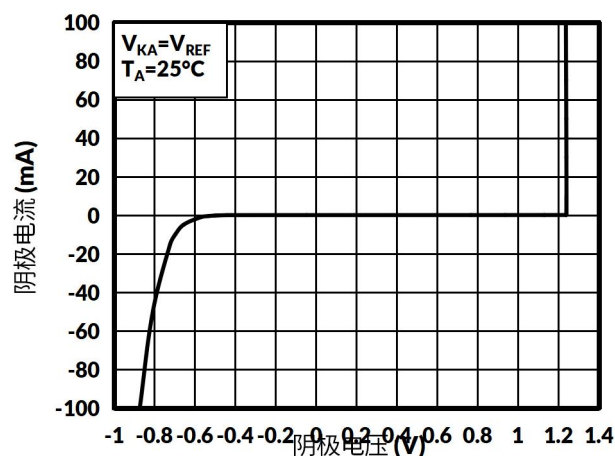


图 4. 阴极电流与阴极电压的关系

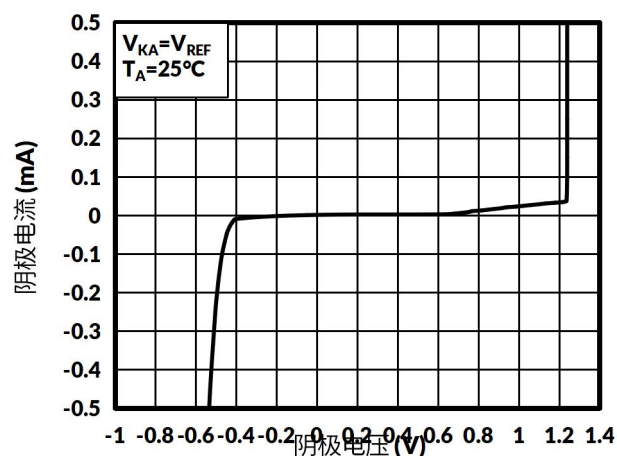


图 5. 阴极电流与阴极电压的关系

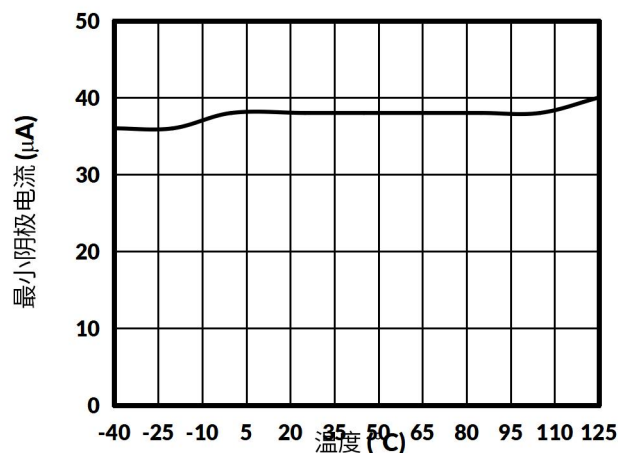


图 6. 最小阴极电流与环境温度的关系

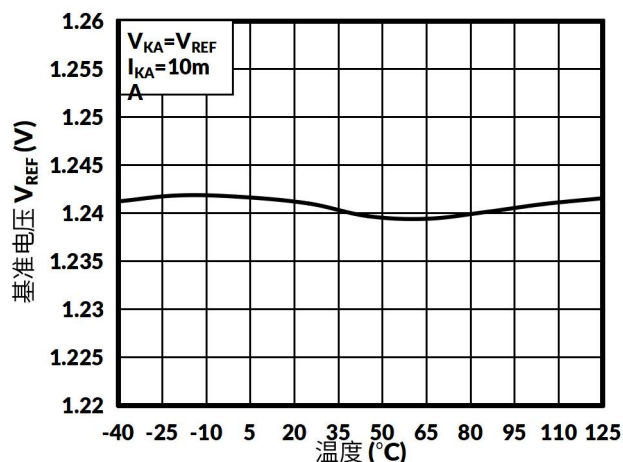


图 7. 基准电压与环境温度的关系

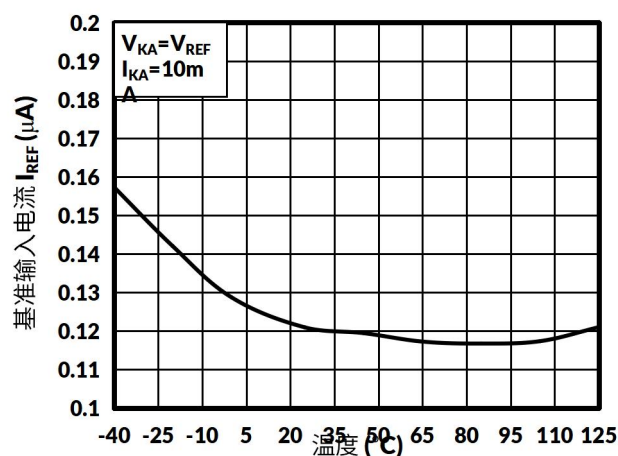


图 8. 基准输入电流与环境温度的关系

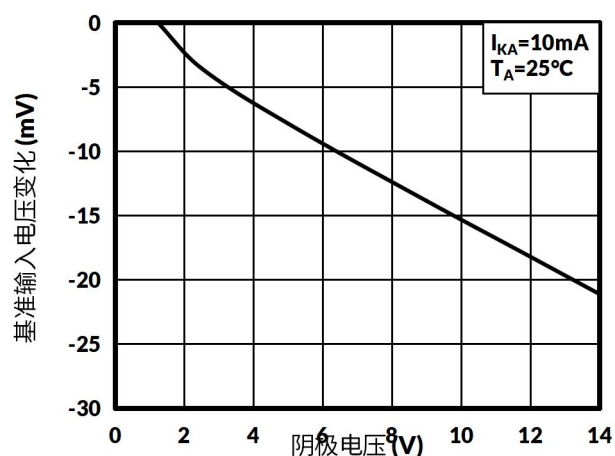


图 9. 基准输入电压变化与阴极电压的关系

典型参数曲线 (续)

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

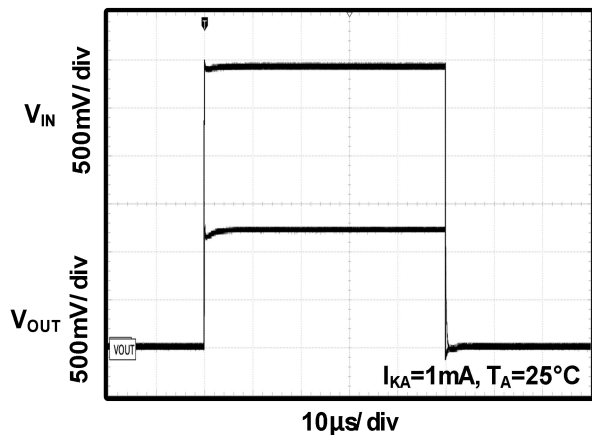


图 10. 脉冲响应

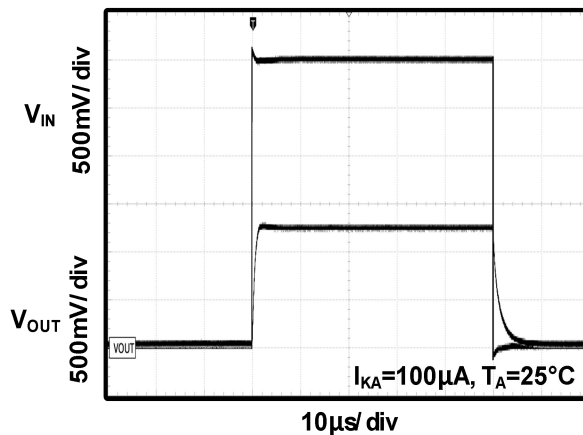


图 11. 脉冲响应

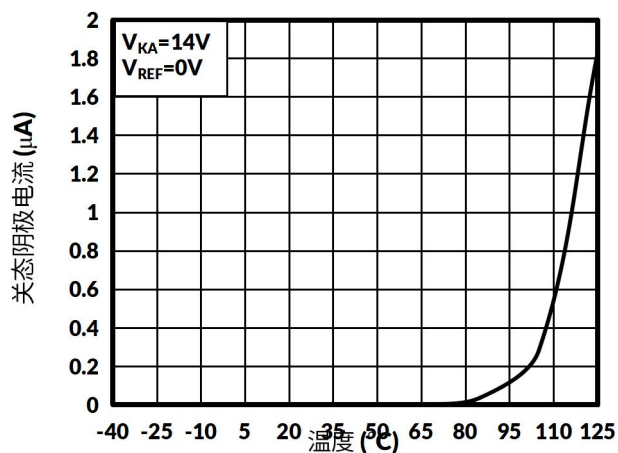
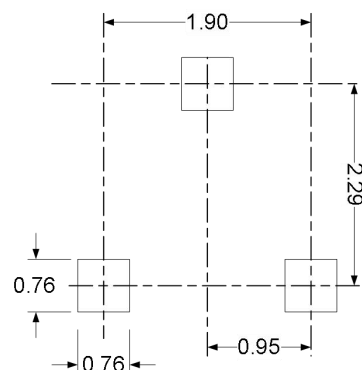
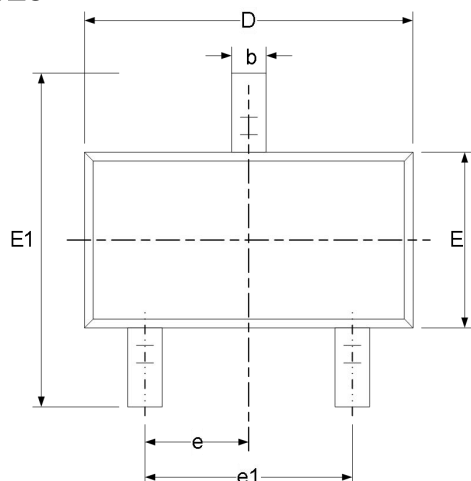
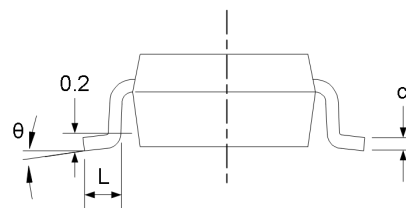
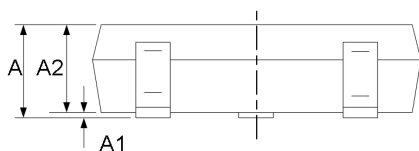


图 12. 关态阴极电流与环境温度的关系

9 封装规格尺寸

SOT23⁽³⁾

推荐焊盘尺寸 (单位: 毫米)



符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.050	0.035	0.041
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.150	0.003	0.006
D ⁽¹⁾	2.800	3.000	0.110	0.118
E ⁽¹⁾	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 (BSC) ⁽²⁾		0.037 (BSC) ⁽²⁾	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.500	0.012	0.020
θ	0°	8°	0°	8°

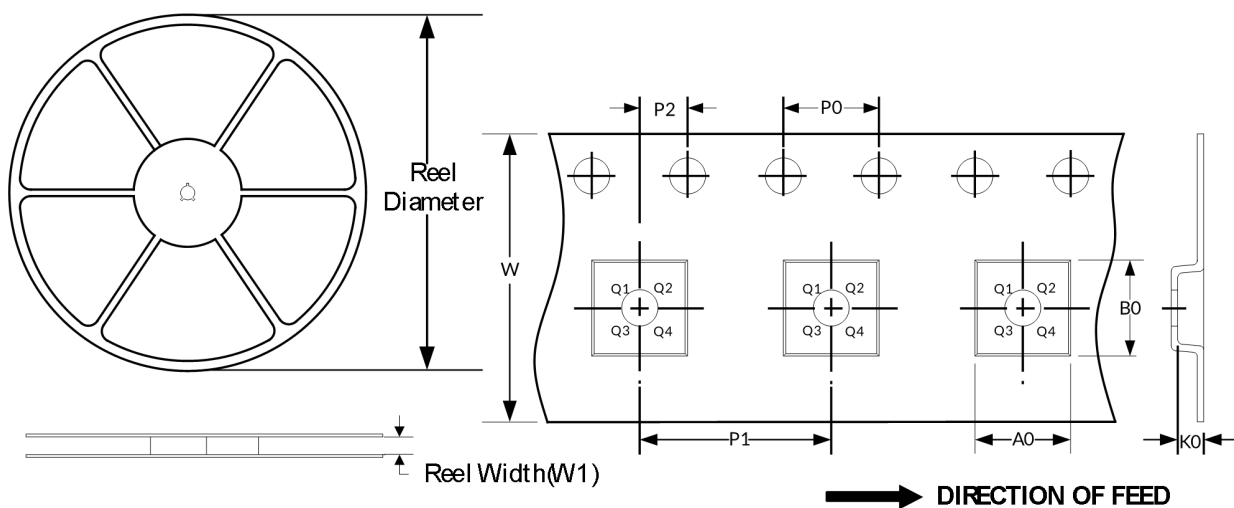
注意:

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. 本图如有更改, 恕不另行通知。

10 包装规格尺寸

卷盘尺寸

编带尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SOT23	7"	9.5	3.15	2.77	1.22	4.0	4.0	2.0	8.0	Q3

注意：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。